

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】令和1年10月3日(2019.10.3)

【公表番号】特表2019-501389(P2019-501389A)

【公表日】平成31年1月17日(2019.1.17)

【年通号数】公開・登録公報2019-002

【出願番号】特願2018-532172(P2018-532172)

【国際特許分類】

G 01 K 7/00 (2006.01)

A 61 B 5/01 (2006.01)

【F I】

G 01 K 7/00 3 4 1 P

A 61 B 5/01 1 5 0

【手続補正書】

【提出日】令和1年8月19日(2019.8.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

受動型デュアル熱流センサであって、

温度監視プロシージャの間に対象に置かれる接触面と、

下側レイヤと、

上側レイヤと、

当該センサの前記下側レイヤの内面に配置される内部サーミスタ、及び当該センサの前記上側レイヤの上面に配置される上部サーミスタを有する縦型サーミスタ配置と、

複数の複合サーミスタ配置と

を有し、

複合サーミスタ配置は、

当該センサの前記下側レイヤの内面に配置される内部サーミスタと、

当該センサの前記下側レイヤの上面に配置され、前記対象から外へ向かう垂直な熱流を測定するよう前記内部サーミスタに対して配置される上部サーミスタと、

前記接触面に沿って水平な熱流を測定するよう前記内部サーミスタと列をなして配置される側方サーミスタと

を有する、

前記受動型デュアル熱流センサ。

【請求項2】

少なくとも4つの複合サーミスタ配置を有する

請求項1に記載の受動型デュアル熱流センサ。

【請求項3】

複数の垂直なサーミスタ対を有し、

垂直なサーミスタ対は、内部サーミスタ及び上部サーミスタを有する、

請求項1又は2に記載の受動型デュアル熱流センサ。

【請求項4】

当該センサの外面は露出される、

請求項1乃至3のうちいずれか一項に記載の受動型デュアル熱流センサ。

【請求項 5】

前記縦型サーミスタ配置は、当該熱流センサにおいて中心に位置付けられる、
請求項1に記載の受動型デュアル熱流センサ。

【請求項 6】

請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の受動型デュアル熱流センサにより対象の温度を測定する方法であって、

当該方法は、

温度監視プロシージャの間に前記対象に前記受動型デュアル熱流センサの接触面を置くステップと、

前記受動型デュアル熱流センサのサーミスタによって収集された温度測定値を受け取るステップと、

前記受け取られた温度測定値に基づいて前記対象の温度を計算するステップと
を有する、

方法。

【請求項 7】

最大の垂直熱流に関連するサーミスタを特定するよう前記受動型デュアル熱流センサの前記複合サーミスタ配置の温度測定値を比較するステップと、

隣接する複合サーミスタを特定するステップと、

前記隣接する複合サーミスタの温度測定値に基づき前記対象の温度を計算するステップと

を有する

請求項6に記載の方法。

【請求項 8】

前記対象の温度を計算することより前に1つ以上の温度測定値を平均するステップを有する

請求項6又は7に記載の方法。

【請求項 9】

前記受動型デュアル熱流センサの前記複合サーミスタ配置の温度測定値を比較するステップと、

信頼できない温度測定値を提供する複合サーミスタ配置を特定するステップと、

前記信頼できない温度測定値を提供する複合サーミスタ配置によって収集された温度測定値を捨てるステップと

を有する

請求項6乃至8のうちいずれか一項に記載の方法。

【請求項 10】

対象の温度をモニタする温度検知配置であって、

請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の受動型デュアル熱流センサと、

前記受動型デュアル熱流センサのサーミスタから温度測定値を受け取り、該受け取られた温度測定値に基づいて前記対象の温度を計算するよう配置される評価ユニットと
を有する前記温度検知配置。

【請求項 11】

前記受動型デュアル熱流センサは、温度測定値を前記評価ユニットへ送信する無線インターフェイスを有する、

請求項10に記載の温度検知配置。

【請求項 12】

前記受動型デュアル熱流センサは無線デバイスとして実現される、

請求項10又は11に記載の温度検知配置。

【請求項 13】

前記評価ユニットはポータブル・デバイスとして実現される、

請求項10乃至12のうちいずれか一項に記載の温度検知配置。

【請求項 1 4】

患者支持デバイスに組み込まれる

請求項1_0乃至1_3のうちいずれか一項に記載の温度検知配置。